

东方证券股份有限公司

关于烟台德邦科技股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对德邦科技变更部分募投项目事项进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527号），公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,556万股，每股面值1.00元，每股发行价格46.12元。本次公开发行募集资金总额为人民币164,002.72万元，实际募集资金净额为148,748.32万元。截至2022年9月14日，上述募集资金已全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字[2022]210029号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2022年9月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司于2022年9月14日公布的《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体
1	高端电子专用材料生产项目	38,733.48	38,733.48	昆山德邦
2	年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	6,241.99	6,241.99	四川德邦
3	新建研发中心建设项目	17,690.85	17,690.85	昆山德邦
4	新能源及电子信息封装材料建设项目	30,776.20	30,776.20	四川德邦
合计		93,442.52	93,442.52	-

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资总额	调整后投资 总额	累计投入 金额
1	高端电子专用材料生产项目	38,733.48	38,733.48	38,439.15
2	年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	11,166.48	6,241.99	5.00
3	新建研发中心建设项目	14,479.23	17,690.85	4,000.30
4	新能源及电子信息封装材料建设项目	30,776.20	30,776.20	24,540.61
5	超募资金永久补流	-	55,305.80	55,353.00
合计		95,155.39	148,748.32	122,338.06

三、本次变更部分募投项目的基本情况

（一）原项目计划和实际投资情况

1、原项目名称：年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目

2、原项目实施主体：四川德邦新材料有限公司

3、原项目实施地点：四川彭山经济开发区产业大道 12 号

4、原项目建设内容：年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目实施完成后，可实现年产半导体芯片与系统封装用电子封装材料 15.00 吨、光伏叠晶材料 20.00 吨的产能。

5、原项目达到预定可使用状态日期：2026 年 9 月

6、原项目实际投资进度：截至 2025 年 6 月 30 日，年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目累计已实际投入募集资金 5.00 万元，该项目尚未使用的募集资金为 6,236.99 万元，存放于募集资金专户中。

（二）新项目的具体情况

1、项目名称：德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目

2、项目实施主体：深圳德邦界面材料有限公司

3、项目实施地点：广东省深圳市龙岗区洪围地块

4、项目建设内容：本项目将与村集体合作开发一块工业用地，该地块已依据深圳专属政策完成农村用地向国有用地的性质转换，并在该地块新建厂房与宿舍，以解决深圳德邦现有租赁场地生产拥挤、实验室面积不足、布局不合理的问题；同时，项目将引入更先进的自动化生产设备，优化导热界面材料的生产工艺，提升导热界面材料和导电胶等核心产品的产能，并配套建设更完善的材料可靠性分析测试实验室，强化核心技术的迭代研发。

新项目产品主要为导热材料及 EMI 材料，细分为导热膏、导热泥、导热凝胶、导热垫片、相变材料、导电胶等，达产后预计年产能 450 吨。。

5、项目实施周期：2 年

6、新项目资金：项目总投资 23,049.54 万元，拟使用原项目剩余募集资金 6,236.99 万元用于本项目。以上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式补足。

投资结构如下表所示：

序号	项目名称	项目投资总额	投资比例
1	建设投资	19,057.01	82.68%
1.1	工程费用	18,556.00	80.50%
1.1.1	建筑工程费	16,356.00	70.96%
1.1.2	设备购置费	2,200.00	9.54%
1.2	预备费	501.01	2.17%
1.2.1	基本预备费	501.01	2.17%
2	建设期利息	637.90	2.77%
3	铺底流动资金	3,354.63	14.55%

4	项目总投资	23,049.54	100.00%
---	-------	-----------	---------

7、新项目备案、环评情况

公司尚未取得用以实施本项目的土地的使用权，公司将在取得实施本项目的土地的使用权后及时办理项目备案和环评手续，后续公司将按照项目进展情况及时履行信息披露义务。

四、本次变更募投项目的原因

本次对部分募投项目进行变更的主要原因如下：

1、公司原项目“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”，是结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定，并经过充分研究与论证。近年来，市场与行业发展发生深刻变化，原项目的产能扩张计划已不再具备先前的紧迫性。基于对当前市场环境和行业发展趋势的深入分析，结合公司整体战略规划，为更好地支持长远发展，公司决定终止该原项目。

2、通过新项目“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”的实施，可实现多方面关键效果：一是摆脱租赁场地依赖，提升生产稳定性、以及生产效率与质量，为生产优化和研发提供稳定硬件载体；二是支撑产能扩张，助力公司达成营收增长目标；三是承接集团南方基地战略，依托深圳政策与产业优势，对接核心客户、优化供应链并吸引高端人才；四是巩固导热界面材料领域竞争优势，保障订单响应、推动产品升级，巩固国产替代地位并助力细分市场拓展。

五、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更部分募投项目是公司综合考虑市场、行业环境的发展变化，根据公司经营发展战略需要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

六、履行的审议程序及相关意见

公司分别于 2026 年 1 月 12 日和 19 日召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目

的议案》，同意将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”，本议案尚需公司股东会审议。

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次将“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”，是公司经过审慎分析后做出的决定，综合考虑了公司业务需求及项目实际实施情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司本次变更部分募投项目，系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司长期发展的战略规划而实施，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于烟台德邦科技股份有限公司
变更部分募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王国胜

王国胜

李天雄

李天雄



东方证券股份有限公司

2026 年 1 月 19 日